

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

灿芯半导体（上海）股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	贝莱德、银华基金、兴业基金、汇添富基金、中欧基金、长城基金、太平资产、中庚基金、前海人寿、国信证券、中泰证券、方正证券、中邮证券
时间	2026年5月21日-2026年5月22日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理庄志青先生 董事会秘书沈文萍女士 证券事务代表石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>公司情况简要介绍：</p> <p>灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。</p> <p>依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市等行业。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、公司 2025 年度经营情况？</p> <p>答：2025 年，公司实现营业收入 72,444.62 万元，其中公司芯片设计</p>

业务实现收入 36,732.54 万元，较去年同期上升 30.69%，公司芯片设计业务报告期内发展情况良好。公司 2025 年度完成流片验证的项目数量为 275 个，较 2024 年增长 44.74%。芯片量产业务实现收入 35,712.08 万元，较去年同期下降 55.83%，主要系本报告期部分客户因其需求变化对公司采购下降所致。报告期内，随着客户需求逐渐恢复及部分项目逐步导入量产阶段，公司芯片量产业务环比呈现改善态势，公司 2025 年下半年芯片量产业务收入较 2025 年上半年增长 54.82%。

## 2、公司 2026 年第一季度经营情况？

答：2026 年第一季度，公司实现营业收入 1.71 亿元，同比增长 23.39%，其中，芯片设计业务实现营业收入 0.58 亿元，同比下降 24.63%，芯片量产业务实现营业收入 1.14 亿元，同比增长 82.29%。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司在手订单金额为 9.22 亿元（含税，下同），其中芯片设计业务在手订单 4.08 亿元，芯片量产业务在手订单 5.14 亿元。

## 3、公司目前新业务和新技术布局情况是怎样的？

答：公司致力于为下游客户提供高价值、差异化的一站式芯片定制服务，借助公司自身在工艺、自主 IP 及 SoC 核心技术方面的优势，公司与业内知名的系统厂商和芯片设计企业开展合作，持续提升公司竞争力。

2025 年，公司提供芯片设计服务的用于国产测试机台的芯片成功流片，该芯片基于 SMIC40LL 工艺，实现了 1,600Mbps 的 DDRIO 接口吞吐率，支持 4 通道的激励输出和对比，同时每个通道拥有 256 组 Time-Sets 的 Edge 选择，实现了测试机台高速数字信号的全相位采集，同时集成了温度传感器，处理器能够根据温度信息动态调整内部电路的 Skew 值。该芯片 MPW 版本一次成功，达到客户机台测试数字芯片的需要。目前该项目的 NTO 版本正在准备中，后续进入量产阶段后有望解决测试机台主控芯片的国产替代需求。

2025 年，公司提供芯片设计服务的智能网络芯片成功流片，该项目在国产特殊工艺平台上进行设计实现，是公司在此工艺平台上的首个项目，也为公司后续在此平台上开展新项目的设计及量产奠定了良好的基础。该项目具有设计规模大、设计难度高的特点，在后端设计方面为公司历史上子模块数量最多的项目，为公司厘清了更大规模更多模块数量设计项目的设计流程，为未来同类或更大规模项目的设计实现打下了良好的基础。

2025 年，公司提供芯片设计服务的单点 LED 驱动芯片目前已通过第二次 MPW 优化功能验证并转入 NTO 阶段，预计将于 2026 年内进行风险量产。该芯片采用创新的单点 LED 驱动应用设计方案，其最大挑战在于单颗 Die 面积以及光学影响。经公司设计团队反复优化，目前已经将芯片面积压缩至单张晶圆 55 万颗的量级并对光学影响做了屏蔽优化。该芯片具有较大的市场需求，后续有望为公司贡献持续的量产业务收入。

目前，公司提供芯片设计服务的工业 5G 芯片正在设计过程中，预计将于 2026 年内流片。该项目使用工业 5GuRLLC 技术，可以满足广泛的工业控制基础需求，解决了传统工业控制场景下的线束问题，下游应用领域包括智能车间、工业机器人等的实时通信。该项目基于 SMIC28nmHKC+工艺，内嵌多个公司自研的高速接口 IP，同时复用公司前期类似项目的设计经验，有望实现对客户的快速交付及量产导入。

目前，公司提供芯片设计服务的车规 ECU 芯片正在设计过程中，预计将于 2026 年内流片。该项目按照车规功能安全 ASILD 标准设计车用 ECU 控制芯片，不仅需要在系统架构、IP 设计、DFT 设计、布局布线等各个环节满足 ACQ100 的基本指标以及功能安全的需求，还需要满足商用芯片在面积、功耗、性能方面的要求。该项目将进一步提升公司在车规及功能安全领域的设计能力及项目经验，随着国内新能源汽车市场的发展，公司在相关领域的商业客户数量亦有望同步增长。

#### 4、公司的研发投入情况及后续的研发规划是怎样的？

答：2025 年度，公司研发投入金额为 1.79 亿元，研发投入比例达到 24.73%。截至 2025 年末，公司共有研发人员 212 人，较去年同期末增加 57 人，研发人员占比达到 61.27%。研发人员中，硕士及以上学历 124 人，占研发人员总数的 58.49%。公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。

#### 5、公司对未来发展的展望？

答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。公司后续主要经营计划包括：

(1) 技术研发创新：公司将进一步加大研发投入，提升自主创新能力、完善研发体系与质量管理体系，对现有的以大型 SoC 定制设计技术与半导

	<p>体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系进行持续研发，不断为客户提供高质量、高效率、低成本、低风险的一站式芯片定制服务。</p> <p>(2) 市场拓展：一方面，公司将加强市场开拓力度，重点布局汽车电子、端侧 AI、AI+IoT 等高潜力领域，加速技术研发成果的市场化应用，增强公司核心竞争力；另一方面，公司将拓展销售与服务网络的覆盖度，提升销售团队整体专业素质，优化公司营销模式。</p> <p>(3) 研发团队建设与管理 7 效能提升：公司重视人才引进，立足公司实际情况，积极同国内外科研院所、高校和企业进行交流，注重国内外高端专业技术人才的引进。与此同时，公司实施人才培养计划，健全公司内部培训、人员考核评价、晋升及优化机制，加强公司在创新文化、员工职业生涯规划、内部知识共享、员工领导能力建设方面的投入，持续提升员工队伍素质。此外，公司还将优化管理流程，提升流程效率，优化整体管理效能，降低公司运营成本。</p> <p>(4) 并购重组与资源整合：在高度竞争的产业形势下，公司将在自身成长的同时，积极寻求并购机会，从而使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将综合评估标的公司的管理团队和企业文化与公司的兼容性，保障公司核心竞争力的加强和进一步发展。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 21 日、2026 年 5 月 22 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无